

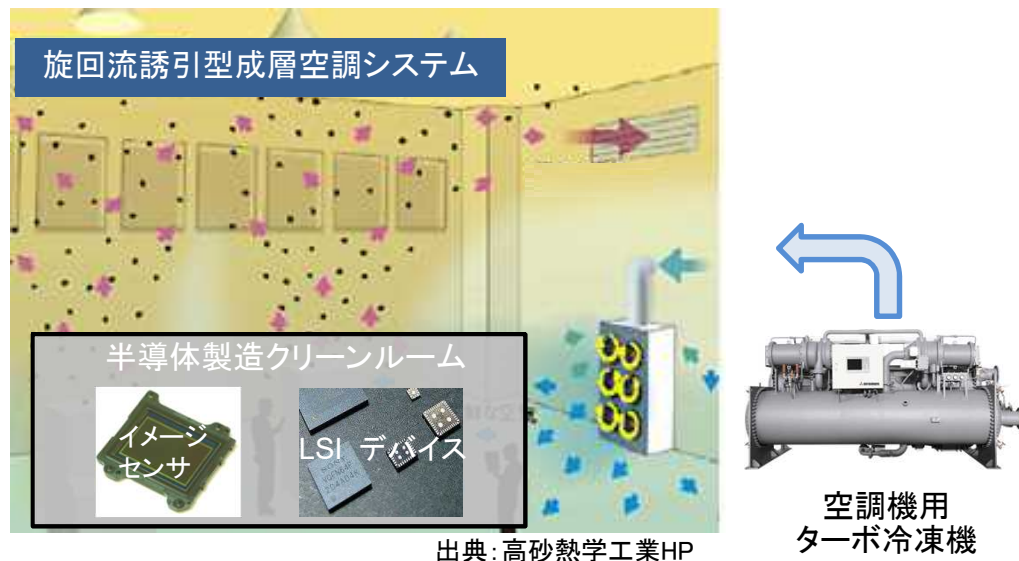
半導体工場における省エネ型空調システム及び冷凍機の導入

プロジェクト実施者（日本側）：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、（タイ側）：Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd.

GHG排出削減プロジェクトの概要

本プロジェクトは、2011年に洪水で被災した半導体（LSI・イメージセンサ）製造工場の改修工事の一部である半導体製造を目的としたクリーンルームの建築（面積：6,250m<sup>2</sup>）において、省エネ・環境性能に優れた「ターボ冷凍機」と「旋回流誘引型成層空調システム」を導入するものである。

当該空調システムは室内の空気を混合せず、体感に関する低い層のみを空調の対象とするものである。そのため、吹出し温度を室温近くまで減らすことが可能となり、冷凍機の負荷が減少できる。また、少ない風量で済むため、ファンに係る消費電力量が低減できる。さらに、冷凍機はインバータを搭載する省エネタイプである。



出典：高砂熱学工業HP

想定GHG排出削減量

**3,744 tCO<sub>2</sub>/年**

JCM設備補助事業実施サイト

ソニーデバイステクノロジー(タイランド)  
バンカディ工場



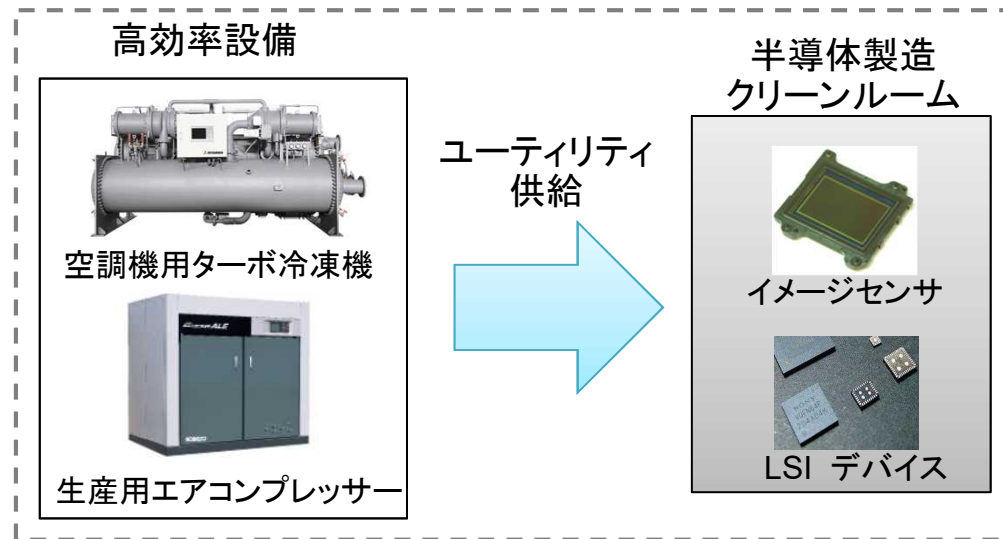
半導体（LSI・イメージセンサ）の製造工場

半導体工場における省エネ型冷凍機・コンプレッサーの導入

プロジェクト実施者（日本側）：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、（タイ側）：Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd.

GHG排出削減プロジェクトの概要

本プロジェクトは、バンガディ工業団地にある半導体製造工場のクリーンルームに、高効率で省エネ性能の高いターボ冷凍機とエアコンプレッサーを導入することにより、エネルギー起源CO2の排出削減を図るものである。  
また、クリーンルームでは温度や湿度を最適にコントロールする必要があるため、高性能の設備が有効である。



想定GHG排出削減量

**365 tCO<sub>2</sub>/年**

JCM設備補助事業実施サイト

ソニーデバイステクノロジー(タイランド)  
バンカディ工場



半導体(LSI・イメージセンサ)の製造工場